

APPROVAL SPECIFICATIONS

Title : T-Flash CARD SOCKETS

ProductModel : TF-111-ARP10

Customer's Part NO :

Customer's Model :

Customer's Approval Requested.

Please return this copy as a certification of your approval

Checked by : Date :

Approved by : Date :

APPROVE	REVIEW	POLT
王凯	李成功	许志明



TF-111-ARP10
W15.95xD14.00xH1.68

PIN 数(Number of contacts) : 8+2PIN

操作方式(Operation mode): 自弹式/PUSH PUSH

温度范围(Operating temp): -40°C TO +80°C

额定负荷(Rated load): 0.5A PERP IN.

接触电阻(Contact resistance): 100mΩ max.

绝缘电阻(Insulation resistance): 1000MΩ min.

耐电压(Withstand voltage) : 500V AC for 1 min

操作寿命(Operation life): 5,000 Cycles Min

焊接温度(Welding temperature): 260±5° 5s

焊接方式(Welding mode): 贴片式/SMT

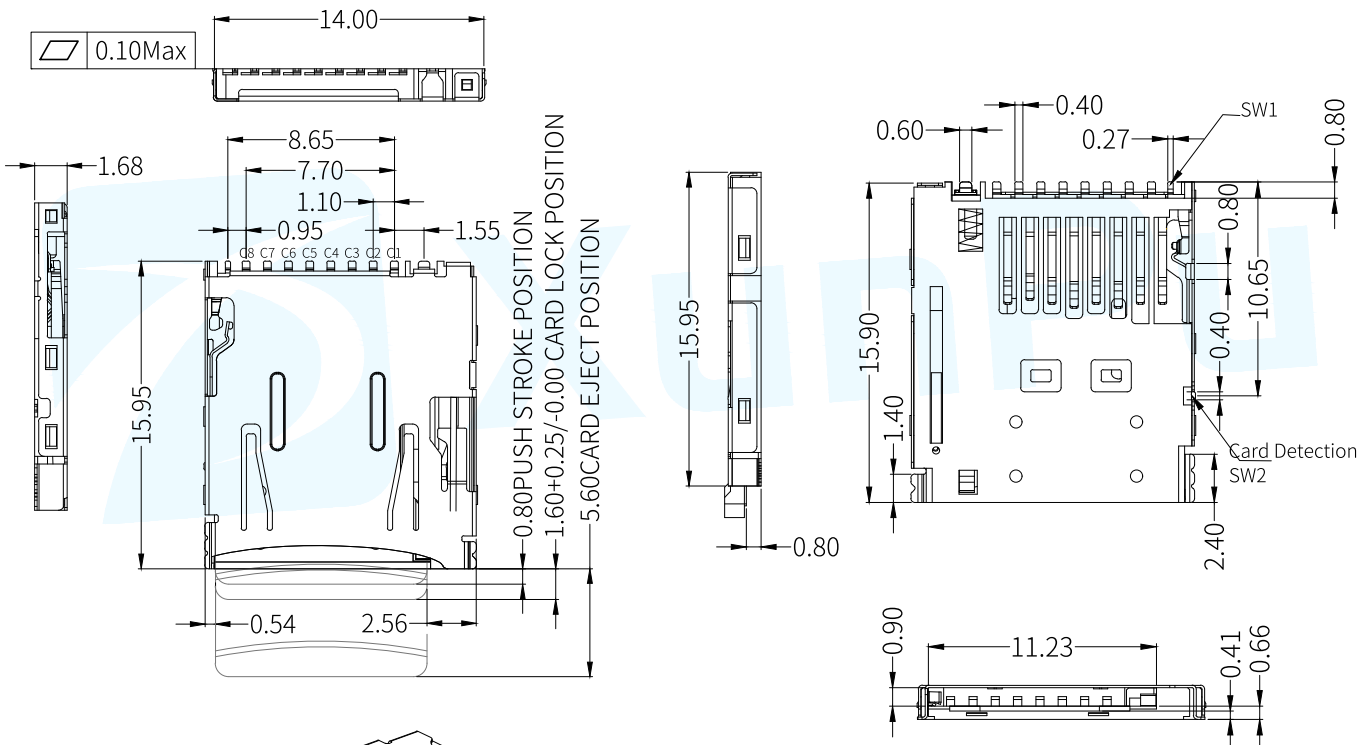
包装方式(Packaging method): 卷带/Tape & Reel (TR)

最小包装(Minimum packing): 1,000/PCS

外形尺寸(UNIT:MM) / Size Chart

www.xunpudianzi.com

更多资料请参考技术选型档!



NOTES

1.MATERIAL:

Housing: High Temperature Thermoplastic
UL94V-0,Color:Black.

Contact: Copper Alloys.

Shell: SUS.

2.PLATING:

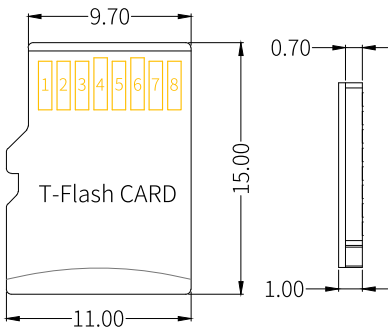
Contact Area: Plated 50u" Nj All, Over all Au 1u.

Shell: Plated 50u" Ni Over All.

Plated 1u" Au Selective Contact Area.

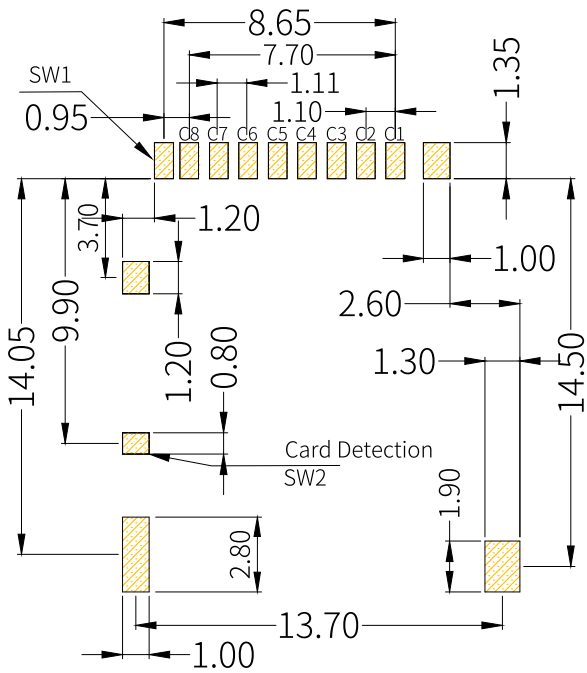
3.MULTIMEDIA CARD COMPATIBLE

T-Flash CARD



引脚定义/Pin Definition

PIN#	NAME	TYPE	DESCRIPTION
C1	DAT2	I/O/PP	DATE LIN(BIT2)
C2	CD/DAT3	I/O/PP	CARD DETECT DATELIN(BIT3)
C3	CMD	PP	COMMAND RESPONSE
C4	VDD	S	SUPPLY VOLTAGE
C5	CLX	I	CLOCK
C6	VSS	S	SUPPLY VOLTAGE GROUND
C7	DAT0	I/O/PP	DATE LIN(BIT0)
C8	DAT1	I/O/PP	DATE LIN(BIT1)

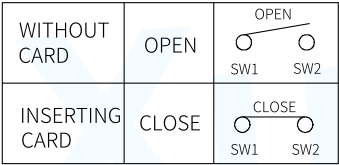


PCB焊盘区(PAD AREA)

禁区(KEEP OUT AREA)

RECOMMENDED PCB LAYOUT
 GENERAL TOLERANCE ± 0.05

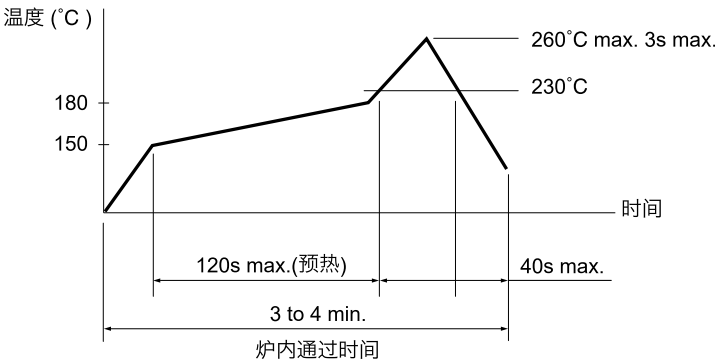
Circuit Diagram for Detect Switch



焊接条件 / Welding conditions

回流焊/Reflow soldering

适用表面贴装型产品/Applicable to surface mount products
 温度分布/Temperature distribution



手焊式/Hand welding

项目/Project	条件/condition
焊接温度 Welding temperature	350°C max.
持续焊接时间 Continuous welding time	3s max.
焊剂斗容量 Flux bucket capacity	60W max.

浸焊式/Immersion soldering

项目/Project	条件/condition
助焊剂附着量 Flux adhesion	不附着于零部件贴装面的程度 Not attached to the mounting surface of components
预热温度 Preheating temperature	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max. The temperature around the welding surface of PCB is 100 °C max
预热温度时间 Preheat temperature time	60s max.
焊接温度 welding temperature	260°C max.
焊接浸渍时间 Welding immersion time	5s max.
焊接次数 Welding times	2 times max.

注:

1. 加热方式:以远红外线上下加热方式。
2. 温度测量:用Φ0.1~0.2 的 CA(K)或 CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面)。
3. 固定方式:采用耐热胶带。

Items	Requirements	Test Methods
1. 温度急变 Temperature rise	不高于 30° 30°CMax.	每根端子负载 0.3A 电流。（UL498） Carry rated current load.0.3A per contact.
2. 低频正弦振动 VibrationSinusoidalLow Frequency	不允许出现超过 1μsec(s)的瞬间断开， 接触阻抗：100mΩ最大； No electrical discontinuity greater than 1 μsec (s) shall occur. Contact resistance:100mΩmax.	对测试样品，在频率变化每分钟从 10-55-10Hz，振幅 1.5mm 条件下，在互相垂直的三个面上，每个面 2 小时下测量， 电流 10mA；适用：MIL-STD-202，方法 201。 Subject mated connector to 10-55-10 Hz traversed in 1 minute at 1.5 mm amplitude 2 hours each of 3 mutually perpendicular plane, 10 mA applied MIL-STD-202, Method 201.
3. 冲击 Shock	不允许出现超过 1μsec(s)的瞬间断开，产品无损坏； No electrical discontinuity greater than 1 μsec. shall occur. No damage to product.	使用合适的固定方式，适用方法.MIL-STD-202，方法 213， 加速度 490m/s2，三个轴上均做测试。 Applying an appropriate holder is allowed in vibration test and shock test. MIL-STD-202, Method 213,490m/s2, 3 axes.
4. 热冲击 Thermalshock	产品无损坏，接触阻抗：100mΩ最大 No damage, Contact Resistance (Low Level) (Final) 100 mΩmax.	温度变化范围：-55°C~+85°C；从-55°C 开始， 30 分钟后换到+85°C；转换时间不超过 30 秒；共 5 个循环。 适用：MIL-STD-202，方法 107D，条件 A。 Temperature range from -55°C to +85°C .Start from -55°C. After 30 min. change to +85°C, change time is no more than 30 seconds. Total 5 cycles. MIL-STD-202, Method 107D,condition A.
5. 恒温恒湿 Humidity	产品无损坏，接触阻抗：100mΩ最大； 耐电压测试 OK,绝缘阻抗 100MΩ最小； No damage, Contact Resistance (Low Level) (Final) 100 mΩ max.. Dielectric Strength should be OK, Insulation Resistance should be 100 MΩ min.	温度：40±2°C96 小时；相对湿度：90-95%； 时间：96 小时；MIL-STD-202，方法 103。 Temperature :40±2°C 96 hours. Relative humidity: 90-95%； Duration: 96 Hours. MIL-STD-202, Method 103.
6. 可焊性 Solderability	样品在测试完成后，用放大倍数为 30 倍的显微镜， 检查外观损坏如：小孔，空焊，外观粗糙度； Appearance of the specimen shall be inspected after the test with the assistance of a magnifier capable of giving a magnification of 10 X for anydamage such as pinholes, void or rough surface.	焊接时间：3~5 秒，温度：255±5°C。 Soldering time: 3 to 5 Seconds Temperature: 255±5°C.
7. 耐焊接热 Resistancetosolderin gheat	产品无损坏 No damage	产品置于 255±5°C 烘箱内 2 分钟。 Leave subject product in the 255±5°C chamber for 2 minutes.
8. 盐雾 SaltSpray	接触阻抗(末态)100mΩmax. Contact Resistance (Low Level) (Final) 100 mΩmax.	盐水浓度（重量比）5±1%， 镀金区域时间 24 小时，镀锡区域时间 8 小时。 温度 35±2°C；MIL-STD-202，方法 101，条件 B。 5±1% salt concentration 24±4 hours 35±2°C MIL-STD-202,Method 101 Condition B.
9. 高温 Hightemperature	接触阻抗 100mΩmax. Contact resistance: 100 mΩmax.	产品置于 80±2°C 连续 96 小时， 适用 MIL-STD-202,方法 108。 Subject product to 85±2°C for 96 hours continuously. MIL-STD-202, Method 108.
10. 低温 Lowtemperature	接触阻抗 100mΩmax. Contact resistance: 100 mΩmax.	产品置于-25±5°C 连续 96 小时， 适用 MIL-STD-202,方法 108。 Subject product to -25±5°C for 96 hours continuously. MIL-STD-202, Method 108.